

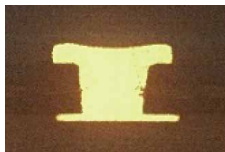
高速伝送対応基板

High-frequency PWB

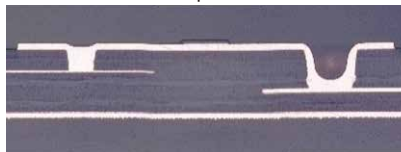
特長 Features

- 高周波材へのレーザービア形成
Laser-Via Formation

レーザービア
Laser Via



R&D スキップビア
Skip Via



- 高精度パターン形成技術
High definition pattern formation

MSAP回路形成
MSAP pattern



MSAP+LVH



用途 Application

- アンテナインパッケージ AiP: Antenna in Package
- IoTモジュール IoT Module
- 6G向けデバイス 6G Device



基板仕様 PWB Specification

項目	ビルドアップ構造	
基板構造	～14層 (全層高周波材)	
高周波材料	(開発中) PPE, サブストレート材	
基板厚み	～2.1mm	
線幅/間隔	サブトラ	MSAP
	外層	Min0.075mm/0.050mm
VIA径/ランド径	内層	Min0.050mm/0.050mm
	内層	Min0.060mm/0.050mm
LVH/ランド径	外層	0.200mm/0.450mm
	内層	0.200mm/0.500mm
インナービアホール/ランド径	高周波材層	0.100mm/0.250mm
	高周波材層	0.150mm/0.350mm

次世代高速伝送 (100GHz以上) 対応への取り組み

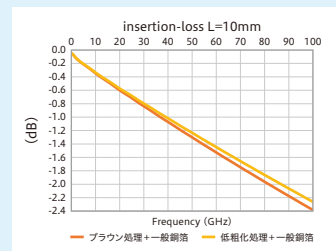
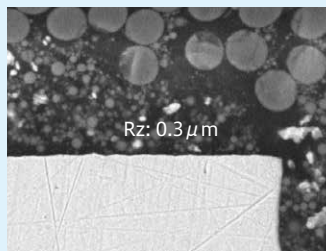
R&D

ストリップライン構造 Stripline

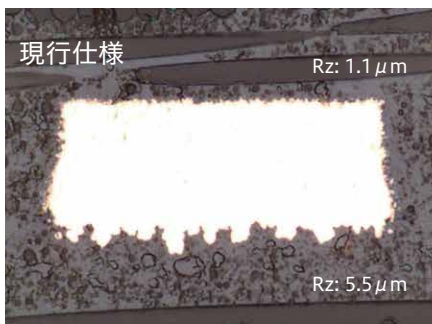
低粗化仕様



低粗化仕様 Low roughness



現行仕様



低プロファイル銅箔 Low Profile Copper Foil

